

NC254 免洗焊膏

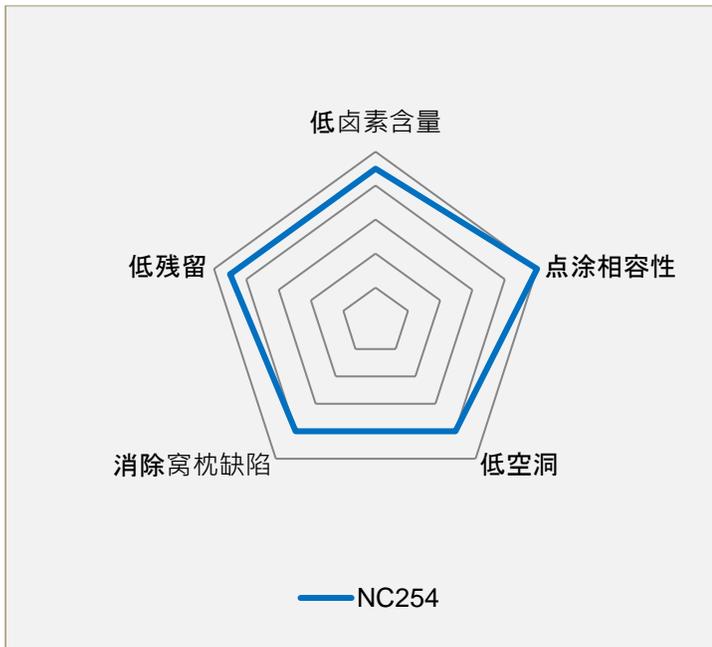
特性

- ▶ 专为点涂应用优化
- ▶ 残留物透明，探针可测
- ▶ 无卤化物、无卤素，符合 REACH 和 RoHS
- ▶ 优秀的润湿性，可润湿无引脚组件
- ▶ BTC 或 Micro-BGAs 上减少空洞缺陷
- ▶ 延长黏附持续时间

描述

NC254 经过特别的设计，使其在用于容积式和气动式点涂器时，都能提供稳定一致的焊膏量。NC254 的助焊剂体系被设计为能够经受锡膏点涂工艺的独特要求，包括重复的机械循环运动。NC254 具有优秀的润湿性和非常低的焊后残留，在高温条件下，其尚存的透明残留物是探针可测试的。NC254 能够减少 BTC 和 Micro-BGA 元件的空洞缺陷。

特点



处理及储存

合金	参数	时间	温度
无铅	冷藏保质期	9 个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
无铅	非冷藏保质期	4 个月	< 25°C (< 77°F)
含铅	冷藏保质期	12 个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
含铅	非冷藏保质期	无	无

NC254 使用 5cc，10cc 和 30cc 规格的 EFD 针筒包装。针筒储存应尽可能的保持尖端向下。当焊膏被打开过之后，不能再重复冷藏。应弃置明显分离的焊膏。详情见 AIM 焊膏使用指导。合金的成分和贮存条件可能会影响保质期。请参阅 NC254 分析证书中的特定信息。

清洁

NC254 点涂器可使用异丙醇清洁。不能将 NC254 留在阀体内过夜。可使用阀调节器来避免清洗点涂器。

回流焊后残留：NC254 回流后残留，无需清洗。AIM 已与行业伙伴合作确保 NC254 残留可用普通助焊剂残留清洗剂清洗。请联系 AIM 获得清洁兼容性信息。

点涂机设置指导

点涂头的选型是成功的焊膏点涂的关键。必须使用能实现所需焊膏量的最大内径的点涂头。气动点涂机应该使用塑料锥形的点涂头。当使用金属点涂头时，应该一直采用长度最短的点涂头。必须使用能实现所需焊膏量的最小压力设置。气动点涂器的压力设置不得高于 40psi (2.75bar)，否则会出现焊膏分离现象。

回流曲线图

请访问 <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. 获得详细的回流曲线信息。联系 AIM 以获得更多信息。

测试数据小结

名称	测试方法	结果	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ROLO	
名称	测试方法	典型结果	图像
铜镜	J-STD-004 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	
定量卤化物、铬酸银测试	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、氟化点	J-STD-004 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟化物	
表面绝缘电阻	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过	可按需提供报告
电化迁移	J-STD-004 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1 GR-78-CORE	通过	可按需提供报告
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	96.7% 典型值	
酸值测定	J-STD-004 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	114 mg KOH/g 助焊剂 典型值	
粘度	J-STD-004 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	300-400 Kcps 典型值	
外观	J-STD-004 3.4.2.5	灰色光滑的膏状	
坍塌测试	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过	
锡球测试	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	通过	
粘性	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	34.2 gf 典型值	